

총평: 전반적으로 HBM에 대한 집중된 관심

■ 3 포인트 요약

1. HBM 수요 지속성 및 동사 경쟁우위

고객소통 기반 하에 내년까지의 HBM 성장에 대한 우려는 無
AI 수요 관점에서 Training 투자 이후 Inference 개화 기대
고객사 피드백 관점에서는 최우수 평가

2. 생산량 조절 및 투자 계획

수요 약세인 NAND의 가동률 10% 이내로 추가 조절 계획
HBM에 대한 투자 리소스 우선 배분 계획이나, 전체 투자 금
액은 기존 계획(-50% Cut) 유지 예정
전반적으로 신규 투자 보다는 공정전환에 방점

3. 재고상황

DDR5, HBM 외의 DDR4 재고 레벨 높게 유지 중
QoQ 재고 전반 소폭 감소, 2분기 재평손 5,000억원 기록
하반기 수요개선과 감산 효과로 재고 감소 가속화 및 일부
재평손 환입도 기대

=====

[2Q23 경영실적 요약]

경기불확실성으로 예상보다 완만한 회복 가운데 AI 수요 증가
DRAM 고사양 서버수요 외에도 모바일 및 PC 수요 재고 빌
드업 영향으로 B/G 증가

DDR4 가격 하락에도 불구하고 고사양 증가로 ASP 증가
HBM 포함 그래픽 DRAM 비중 20% 수준으로 성장
고용량 DDR5 비중 크게 확대되며 출하량 및 ASP 상승

메모리 업황 회복기 진입으로 판단

□ 영업이익: -2.9조원(적자폭 축소)

판매량 증가에 따라 매출원가 증가한 반면

비용절감 노력에 따라 판매 및 일반관리비 감소

DRAM 가격 환경 개선되며 재고평가손실 규모 축소

□ 응용별 실적 및 하이라이트

· DRAM

B/G: QoQ +30% 중반

ASP: QoQ +HS%

· NAND

B/G: QoQ +50%

ASP: QoQ -10%

□ 재무상태

현금보유: 7.49조원(QoQ +1.36조원)

차입금: 30.8조원(QoQ +2조원)

[향후 시장 전망]

□ Bit growth 전망

· DRAM

(기준) 23년 B/G 수요 한자릿수 중후반

(신규) 23년 B/G 수요 한자릿수 중후반(전망유지)

고용량 제품 및 HBM 수요에 적극 대응

DDR5와 고성능/고용량 LPDDR5 판매 확대

3분기는 10% 초중반 QoQ 증가

· NAND

(기준) 23년 B/G 수요 10% 중후반

(신규) 23년 B/G 수요 10% 중반(톤다운)

176단 기반의 SSD 제품 판매 확대

3분기는 전분기 수준의 출하량 유지

□ 응용별 수요 전망

· PC

2분기간 가격 하락 프로모션 영향으로 채널 재고 감소

판매량도 전분기 대비 개선

단, 크롬북 및 **저사양 노트북 교체 수요 중심의 판매**

확대로 메모리 채용량 측면 영향 제한적

하반기 기업용/게임용 PC 중심 수요 증가 예상

· Mobile

중국 리오프닝에 따른 수요 개선 저조

신제품 출시 및 메모리 가격 하락으로 인한 채용량 증가

영향으로 하반기 스마트폰 수요 개선 전망

Flagship 중심 고용량/고성능 LPDDR5 수요 확대 전망

· Server

IT 투자 위축 및 **CSP 업체 재고 조정 영향으로**

'23년 수요 다소 둔화

단, 생성형 AI發 고사양 서버 수요 급증, 고용량 DDR5/
HBM 등 고사양 메모리 제품 수요 빠르게 성장

중장기 AI형 서버 시장은 연평균 30% 중반,

전체 서버 수요는 연평균 한자릿수 후반% 성장 기대

[Capex 전망]

· '23년 투자 전년 대비 50% 이상 축소하여 집행 中(유지)

· 메모리 수요는 2분기부터 회복세를 보이고 있으나, 작년
하반기부터 높아진 재고수준을 정상화하기에는 여전히 부
족한 상황

· NAND는 DRAM에 비해 업계 재고수준 더 높고 수익성

도 낮은 만큼 기존 **NAND 감소 규모 확대 통한 재고 정상화 추진**

- 제한된 투자 下 올해 수요 성장 주도할 고용량 DDR5/HBM3에 필요한 capa 확보를 위한 생산성 향상 · 장비 납기 단축 · 투자 절감 진행
- **기존 연간 투자 계획을 유지하여 집행할 계획**

[Tech roadmap]

1bnm 기반 서버용 DDR5 인증 中

- HKMG 공정 적용, 1anm 대비 전력 소모 20%+ 감소
- 1H24 1bnm, LPDDR5T와 HBM3E에도 확대 적용

1anm 기반 DDR5 full line-up 우위

- 1anm DDR5는 업계 유일 16Gb/24Gb, 128GB 이상 고용량 모듈 등의 제품 인증 완료, 다양한 제품 포트폴리오 보유

HBM 시장 내 높은 점유율과 제품 경쟁력

- 세계 최초 12단 적층, 현존 최고 용량 24GB HBM3 공급 가능
- **23년 (DDR5 128GB 이상 고용량 서버 모듈 + HBM) 매출 전년 대비 2배 이상 성장**

※ 주요 질의응답

Q1) 2분기 Bit growth 높은 이유 IT 수요 낮은 상황에서 고객사의 구매 요인? 3분기 지속가능 여부?

A1) **DRAM:** AI 수요 크게 늘어나면서 DDR5, HBM 출하량이 전분기 대비 두배 이상 성장이 주요요인. 1분기 재고 수준 낮아진 PC와 모바일 고객 위주 일부 재고 빌드업 수요 있었음

PC 채널 재고 개선 효과, 모바일의 경우 플래그십 선호로 고용량 메모리 중심 수요 증가 움직임 확인

NAND: 수요 불확실성 연내 지속 전망. 재고 건전성 차원에서 전 응용에 걸친 판매량 증가 추진

3분기 전망은, DRAM의 경우 AI 관련 DDR5, HBM 고용량 모듈 등의 수요 가시성은 상당수준으로 확보되어 있음. 2분기와 유사한 모습의 수요 예상

NAND의 경우 기저가 컸기 때문에 2분기와 유사한 출하량 예상. 실수요 위주 판매 및 응용 믹스 조절로 수익성 추구 예정

Q2) HBM & DDR5 매출액 비중과 연말기준 비중?

A2) HBM 포함 **그래픽 DRAM 매출액이 4Q22 대비 빠르게**

증가해 전체 DRAM 매출액의 20% 상회하는 상황

DDR5의 경우, 수요 약세인 DDR4의 생산량을 줄여 DDR5 비중을 늘리고 있기 때문에 시장 대비 2개 분기 정도 앞서 준비 중

HBM과 고용량 DDR5 모듈의 경우 두 제품 매출액이 작년 대비 두배 이상 성장 예상. 상반기 보다 하반기에 증가하는 모습이며, 연간 20% 이상의 비중 예상

Q3) DRAM 수요 전망을 유지하셨는데, 시장 조사기관의 하향하는 모습과 차이가 있는 이유는?

A3) 매크로 불확실성으로 전 영역에 걸친 수요 약세 지속. 동사 역시 연초 전망치 하향. 현재는 수요 전망 유지. 연초 대비 스마트폰과 PC, 서버의 수요 둔화되고 있지만, 2분기부터 AI향 서버 수요 증가하며 기타 약세부분 상생.

하반기 계절성 영향과 함께 모바일 신제품 수요 증가 예상. 내년 매크로에 따라 달라지겠지만, 2년 연속 저조했던 수요의 대체 수요 발생 예상. 서버의 경우에도 그동안 줄었던 구매의 영향으로 내년 증가 예상.

Q4) HBM3 이후 로드맵, 경쟁사와의 차이?

A4) 가속기 시장을 주도하고 있는 그래픽 프로세서의 출시 간격을 주목해야 함. HBM2E, HBM3에서의 경험을 기반하면 2년 간격으로 제품 라이프사이클 움직이고 있고, 26년경부터는 HBM4 적용 예상하며 맞춰 준비 중.

고객의 피드백을 종합해 보면, 제품 완성도, 품질 등 SK하이닉스가 가장 앞선다는 반응.

Q5) HBM, 장기적으로 수요 강세에 이견은 없는데 빅테크들의 자체 LLM 투자를 나서고 있는데, 투자 일단락 이후 투자의 휴지기 가능성과 HBM 동반 휴지기 진입 가능성?

A5) 플랫폼 업체들이 단기간의 Capex 투자 이후 휴지기 가능성이 없을 것이라고 부정하기는 어려울 듯. 다만, 내년도까지 두고 보면 어느정도 장기적 가시성은 확보하고 있다고 판단.

플랫폼들이 트레이닝 위주로 준비를 하고 있는데 결국 향후 추론 영역으로의 확장 가능성이 있기 때문에 단일 업체 기준으로는 투자-휴지기-보완의 패턴이 있겠지만, 업체들 복합적으로 투자 패턴 진행될 경우 휴지기의 기간이 매우 짧거나 강도가 약할 것으로 판단.

향후 사전 트레이닝 기반에서 실시간 기반의 AI 서비스가 제공되어야 할 것으로 예상되기에 지속되는 트레이닝 수요가 있을 것으로 전망.

Q6) HBM3 경쟁사 진입 가능성과 경쟁사의 2.5D 기반 고객 프로모션 등을 고려하면 내년 상반기부터 경쟁상황 달라질 수 있지 않을까?

A6) 경쟁사 언급은 어렵고, 내년 하반기 HBM3E가 본격적으로 양산 및 확대되는 시기임. 주 고객들과 논의 중이며 Capa 준비하고 있는 것으로 보면 내년까지의 HBM 성장세 우려는 없다고 믿고 있음. 다만, 고용량 모듈의 경우 Capex 투자 부담이 없는 것이 아니기에 플랫폼 업체들의 계획에 맞춰 대응할 계획

Q7) 2분기말 기준 재고수준과 재고평가손실 규모, 향후 재평가 손실 발생 가능성?

A7) 판매확대와 감산효과로 2분기말 재고는 소폭 감소. 제품별로 경향은 다소 상이. DDR5, HBM 중심으로 판매 늘어 재고 감소한 반면, DDR4, LPDDR4의 경우 여전히 전방수요 약세로 회복세 더뎠지 않은 수준의 재고 보유 중.

하반기는 상반기 대비해서 개선된 수요와 감산효과 영향으로 연말 재고는 현재보다 상당부분 축소 기대.

2분기 약 5,000억 가량의 재고평가 손실 인식. 하반기 재고 감소 가속화와 가격 안정화 예상되는 상황이기 때문에 추가 발생 가능성은 낮다고 판단하고 있음. 만약, 발생하더라도 규모는 미미하다고 판단하며, 일부 제품에 대해서는 환입 가능성도 있음.

Q8) Kioxia, WDC 합병과 관련된 주주로서의 입장과 의견?

A7) NAND 사업 자체가 매우 어려운 사업환경에서 전개되고 있다 보니 일부 언론에서 양사 합병의 속도가 붙은 것으로 보기가 되는 경향이 있음. 동사 또한 모니터링 하고 있으나, 아직까지 합병과 관련해 구체적 논의를 전해 들은 바는 없음

Q9) 최근 고용량 DDR5와 HBM 수요 강세를 감안할 경우 1nm와 이후의 Tech node 전략은? 투자가 크게 늘지 않을까?

A9) 올해 증가하는 고용량, HBM Capa를 연초 대비 다소 조정하여 운영하고 있음. HBM 양산 확대에 필요한 1Z 확대와 내년에는 HBM3E를 위한 1bnm와 TSV capa 확대 준비 중.

올해는 제한된 투자범위 내에서 타 영역 투자를 절감하여 HBM 수요에 대응하고 있음. 내년에는 기술경쟁력 유지 및 늘어나는 수요 대응 위해 올해와 같은 최소한의 투자 규모로는 한계가 있을 것으로 판단. HBM 양산 확대를 위한 투자에 우선순위를 두되 전사적으로는 설비투자 보다는 공정전환에 집중해 Capex 전략 구사 예정.

Q10) DRAM, NAND 감산 규모는 어느 정도로 예상하는지?

A10) 4Q22 부터 레거시 위주로 감산 진행 중. 23년의 경우 DRAM과 NAND 생산 모두 YoY 감소 예상. 특히 NAND의 경우 재고 수준이 DRAM 보다 높고 수익성이 나쁜 상황이라 현재 대비 약 5 ~ 10% 수준의 추가 감산 결정

Q11) 수요 대응 및 리더십 유지 위해 Capex 필요할 텐데, 자금 조달 및 투자계획은?

A11) 대외 불확실성, 가격 하락 등 어려운 시황 지속되고 있음. 현재 수익성 위주 제품 믹스 조정과 설비투자 축소, 경비절감 등으로 시장 대응 중. 올해 급성장하는 DDR5, HBM3 고객 수요 대응위한 투자는 차질없이 진행 중.

투자 대응하고는 있지만, 전사 투자 규모 자체는 기존 계획대로 50% 이상 축소를 유지할 예정. 연초 선제적 자금조달로 리소스 확보한 상황이고, 2분기부터 매출액 증가하는 동시에 투자 지출 제한된 만큼 하반기 현금흐름 개선될 전망.

Q12) 중국 생산. 유예 추가적 연장 여부

A12) 장비수출 유예관련, 종합적인 부분 고려해서 향후 중요 계획에 대해서 회사는 다각도로 검토중. 안정적 사업 운영 위해서 장비수출 통제관련해서는 각국 정부 등과 긴밀하게 협의중

Q13) DRAM AI 수요 강세로 상당히 조기 수익성 반등 기대감 있는 반면 NAND 적자축소 쉽지 않고 어려움 지속되는 상황. NAND 사업 현황과 대응방안은?

A13) NAND는 상대적 AI 향 서버수요 영향이 DRAM 대비 제한적. 여전히 업계 재고수준 높아서 어려운 상황 지속되는 중. 기존 발표 수준 감산 규모 외에 앞서 언급한대로 추가적 NAND 감산 확대해서 재고 정상화 시기 앞당기려고 함.

그 외에도 전사차원 CAPEX, OPEX 관리 지속적 강화. 당사 NAND와 솔리다임간 개별 역량 통합. 비용구조 개선 위한 조직구조 간소화 등 중복비용 계속해서 제거해나갈 계획. 하반기 실수요 위주 ~ 응용 믹스 통해 수익성 위주 강화. 고부가제품 믹스 확대 통해서 업황 회복될 경우 빠른 실적 개선 가능하도록 컨트롤러 기술 개발 등 SoC 경쟁력 확보에도 주력할 계획.

Q14) HBM 수주형 산업으로서 장기적 가격 협상력 유지 가능 여부, DRAM M/S 변화 및 사이클 내 이익률 변동성 완화 기여 여부?

A14) HBM 같은 SiP 형태 제품은 기획 초기부터 대규모 R&D 투자, 고객과의 Capex 협업 등이 수반됨. 전술한대로 2년 단위 정도의 사이클인데 적정 ROI 등 감안해서 적정 가격 산정. 대부분 이부분이 연간단위로 고객들과 협의 중.

대부분 다른 디바이스 산업은 사전 Validate가 존재하는 반

면, HBM은 가속기와 기획/인증이 동시 진행되고 밸류체인내 사전 Capa 준비중이 일어나야 해서 이러한 Long Range Plan에 대한 상호간 이해가 매우 높다고 할 수 있음

이러한 부분이 HBM4 로 넘어가면서 Ecosystem 이 더 복잡해지게 되는데 기존 타입 제품과는 그래서 다른 BM 이 이 때까지도 유지될 것으로 전망. 결국 그렇다면 수주형 사업으로서의 가격 결정력이든지 이익 변동성 완화에 어느정도 기여할 수 있음. B/G 점유율 측면에서도 저희에게 긍정적 효과 줄 것으로 기대중이다.

= 끝 =